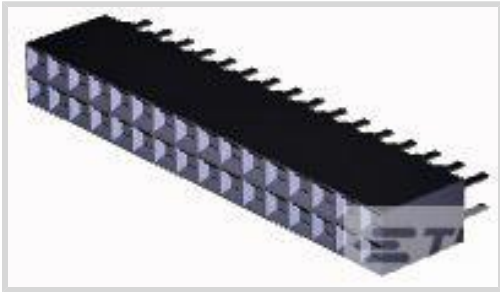




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装母端

连接器系统: 板对板

位数: 32

行数: 2

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

施加的压力	标准
PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

可堆叠	是
位数	32
行数	2
PCB 安装方向	垂直
板对板配置	平行

电气特征

工作电压	333 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压（最大值）	750 Vrms

主体特性

连接器外形	标准
-------	----



主要产品颜色	黑色
接触件特性	
	150 – 300 μin
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子形状和构造	短点
端子保护类型	闭合入口壳体
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子接合区域电镀材料厚度	3.81 – 7.62 μm[150 – 300 μin]
端子接触部电镀材料	锡铅
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	2 A
端接特性	
矩形端接柱体和尾部宽度	.69 mm[.027 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
端接柱体和尾部长度的	3.18 mm[.125 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带
壳体特性	
接合入口位置	顶部
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	聚酯 GF
尺寸	
连接器高度	5.03 mm[.198 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]
堆叠高度	10.92 mm[.43 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
使用环境	



壳体温度额定值	标准
工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	14
封装方法	Box, Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (13% in 4690948374) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | **Modu 连接器系统**



客户还购买了



文档

产品图纸
32 MODII RCPT VERT DR
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-146762-8_K.2d_dxf.zip
英文版本
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-146762-8_K.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-146762-8_K.3d_stp.zip

1-146762-8

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 32 Position, 2.54 mm [.1 in]
Centerline, Tin-Lead, Through Hole - Solder, Modu Connector System



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本